

2015年3月期 (中間)決算説明会

2014年11月12日
TOWA株式会社
東証1部:6315

CONTENTS

◎(中間)決算概要

- ☆2Q連結業績結果
- ☆特別損失の計上について
- ☆業績見通しの上方修正

◎TOPICS・新たな市場

- ☆コンプレッションの展開状況
- ☆ガラスカット事業
- ☆自動車関連市場の拡大
- ☆「バンセラ」、「TSS」、「工具販売」
- ☆欧米評価ラボ活用によるマーケティング

2015/3期 第2四半期(累計)連結業績結果

(億円)

	期 初 計 画	8/8 修正	実 績
売 上 高	100.0	109.0	109.1
営 業 利 益	8.5	12.0	11.4
経 常 利 益	8.0	11.0	14.7
純 利 益	7.5	11.0	10.9

※営業利益は海外子会社連結時の為替換算による影響(213百万円)を受けております。詳細は11/11付「営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

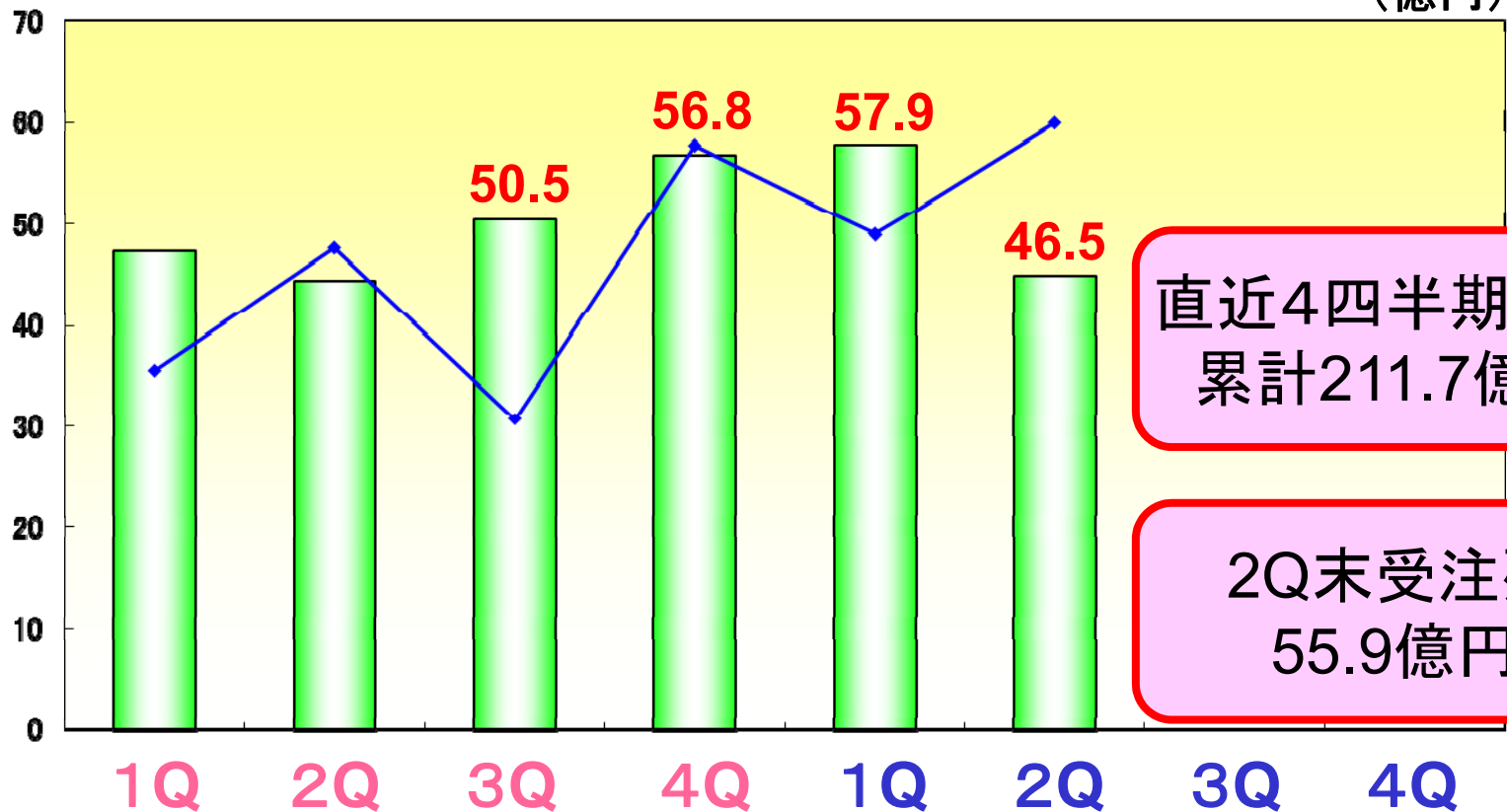
2015/3期 第2四半期(累計)セグメント別売上高

(億円)

		2Q計画	2Q実績
売	上	高	
		100.0	109.1
	半導体製造用等精密金型	33.0	30.2
	モールドイング装置	50.0	59.2
	LED樹脂封止装置・金型	6.0	9.8
	シンギュレーション装置	4.0	4.0
	ファインプラスチック成形品	6.0	5.9
	新たな市場	1.0	(1.2)

受注高・売上高の推移

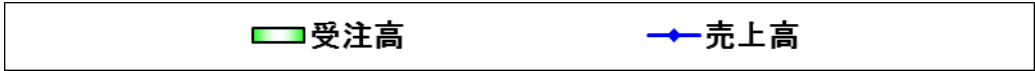
(億円)



直近4四半期受注
累計211.7億円

2Q末受注残
55.9億円

← 2014/3期 → ← 2015/3期 →



設備投資・研究開発費

(単位：百万円)

	通期計画	2Q迄実績
設備投資	1,300	478
研究開発費	150	97

⇒設備投資・開発計画は予定通り実施

⇒減価償却費等の損益インパクトは計画通り

特別損失の計上

- ☆損失の内容 : 創業者功労金の贈呈
- ☆金額 : 300百万円
- ☆処理(引当金): 当第2四半期に計上



第37回定時株主総会(2015年6月予定)
での承認後、贈呈する予定

※平成26年9月26日付「創業者功労金贈呈に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

2015/3期 (通期) 連結業績予想

(億円)

	下期計画	下期修正	通期修正	(期初計画)
売上高	80.0	100.9	210.0	180.0
営業利益	1.5	8.6	20.0	10.0
経常利益	1.0	8.3	23.0	9.0
当期純利益	0.5	7.1	18.0	8.0

※下期計画を上方修正し、通期計画も上方修正

2015/3期 通期セグメント別売上高(修正)計画

(億円)

		期 初 計 画	修正計画
売	上 高	180.0	210.0
	半導体製造用等精密金型	59.0	60.0
	モールディング装置	88.0	113.2
	LED樹脂封止装置・金型	11.0	14.8
	シンギュレーション装置	8.0	8.0
	ファインプラスチック成形品	12.0	12.0
	新たな市場	2.0	2.0

配 当 計 画

	2013/3期	2014/3期	2015/3期 計画
配 当	10.0円	10.0円	10.0円
(連結配当性向)	(36.2%)	(44.0%)	(13.9%)

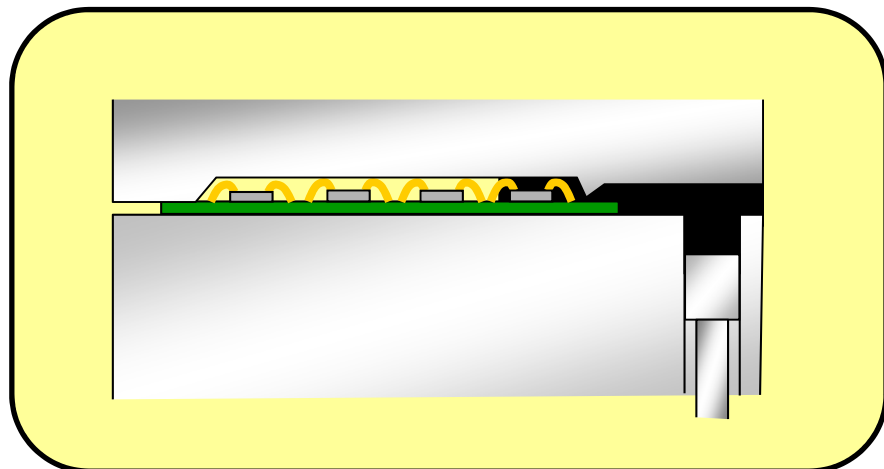
配当方針 「安定・継続配当」に基づき、
期末10.0円を予定。

上方修正の主な要因

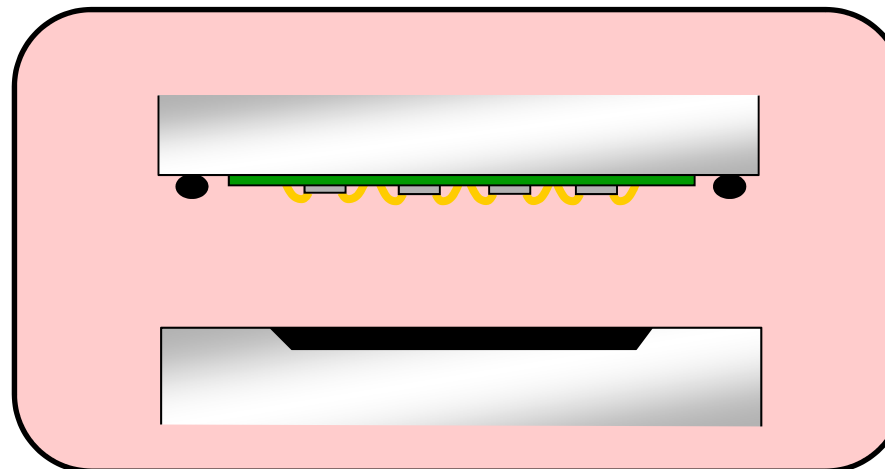
1. **中国スマホ好調**→主要OSATの投資は堅調
2. 半導体・電子部品の需要強い→**大崩れは無い**
3. **コンプレッション**が順調に浸透・拡大
4. **韓国メーカーの動向**に期待
5. LEDマーケット(WLPや**LED照明の低価格化**)
6. シンギュレーション黒字確保、**シェア拡大**へ

トランスファとコンプレッションの比較

トランスファモード



コンプレッションモード



コンプレッション
による様々な
メリット

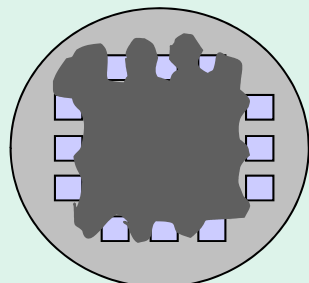
- ・ 製品品質の向上
- ・ 基板の大型化
- ・ ワイヤー細線化
- ・ 樹脂使用量低減
- ・ 生産性の向上

TOWAのコンプレッション技術

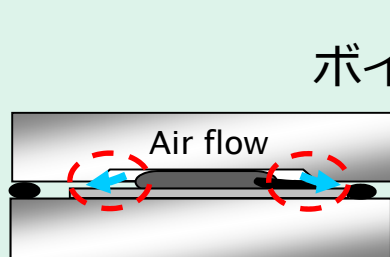
液状樹脂



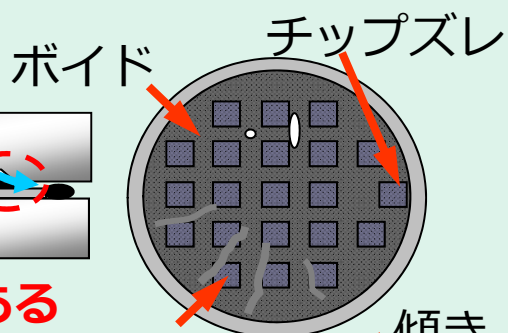
樹脂が均一に供給出来ない



樹脂流動が不均一

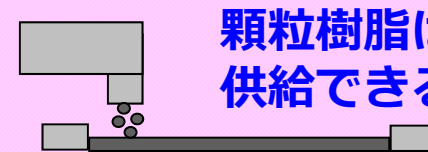


樹脂流動がある

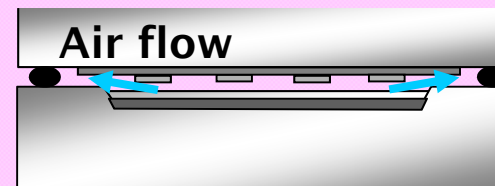


不良が発生する

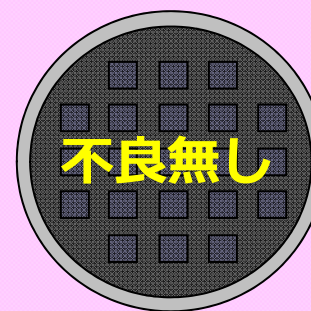
顆粒樹脂



顆粒樹脂は均一に供給できる



樹脂流動が無い



不良無し



不良無し

CPM 1180

プライベートショー
展示機

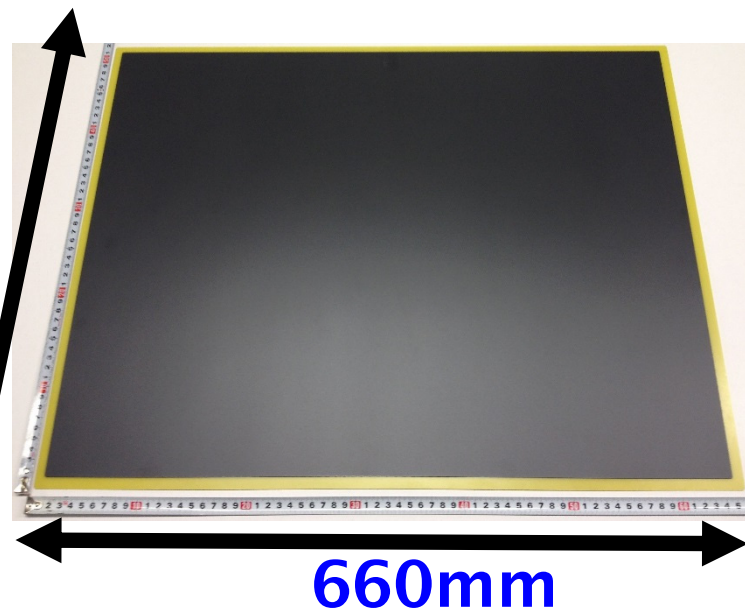
⇒プリント基板製造装置へ応用

上期より販売・納品スタート

☀️ プリント基板メーカー向け

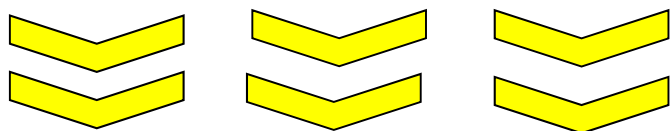


515mm



660mm

「ノイズスキャナー」の一体成形



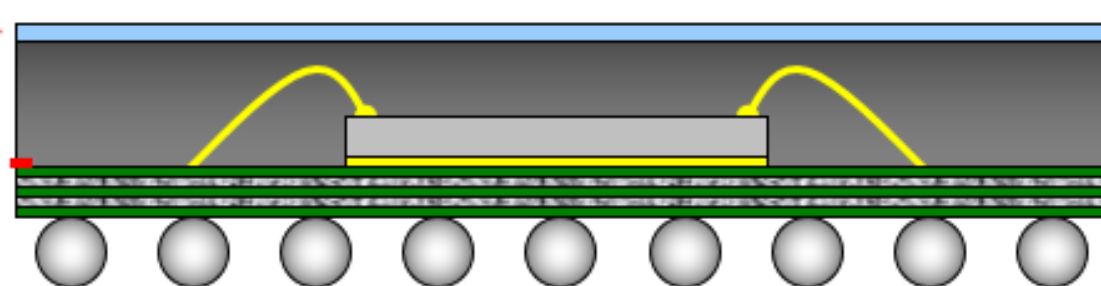
プライベートショー
展示機

高周波モジュールのノイズスキャナー
一体成形プロセスとして注目
ファブレス等と共同開発契約

PMC 1040
HEATSINK



Heat Sink by Compression



新たな市場：ガラスカット事業

**初号機を韓国ユーザーに
搬入！！**

- ☆ スマホ・タブレット・車載品等を
中心にタッチパネル需要拡大
- ☆ 韓国市場での需要が大きい



**TOWA韓国の販促活動及び
韓国国内製作で進める**

ガラス切断装置に参入
TOWAドライエッチング応用

【京産】TOWAはスマートフォンなどの内蔵カメラガラス切断装置事業に参入する。ドライエッチング技術を活用したのが特徴で、強化ガラスであっても高い透明率で切断できる。

大判ガラスの表面化学処理やタッチセンサー形状などを施した上で精密サイズに切断することで、ガラススマートフォンやモバイルカーナビなどで生じる、表面の凹凸や傷を防止し、透明率を向上させている。

そのためには、ガラスを個別に加工したガラスに、さまざまな処理をするのが一般的。ただ、この方法では生産性の向上に限界がある。そこで同社は、ドライエッチングによる高精度プロセスにより、大判のガラスを連続して切断する方式を確立した。

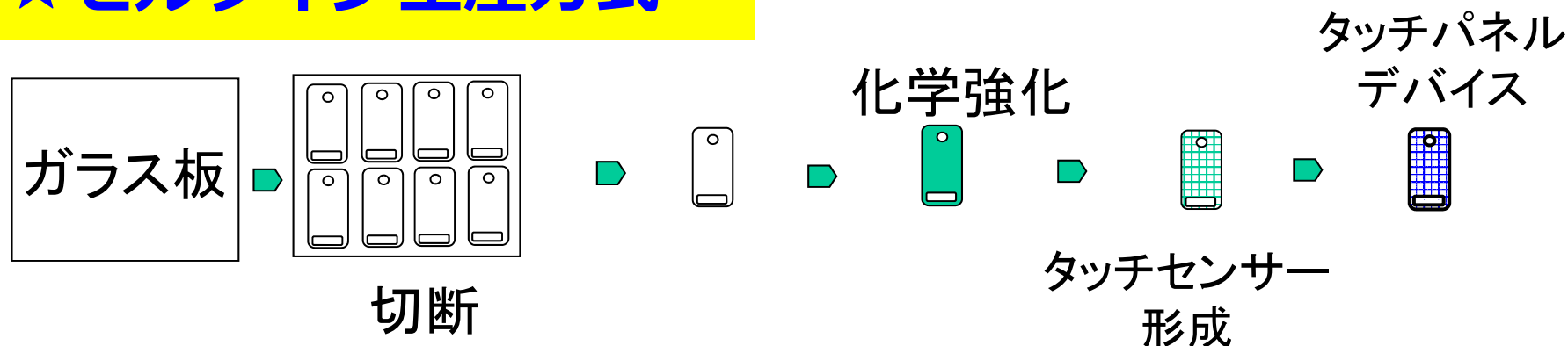
開発した切断装置はガラスの両面にエッチング時にマスクとなる特殊フィルムを貼ったことで、

切替部分のフィルムをレーザーで剥離してエッチングする仕組み。強化ガラスでは困難だった複雑な加工にも対応し、デザインの出回も高まる。

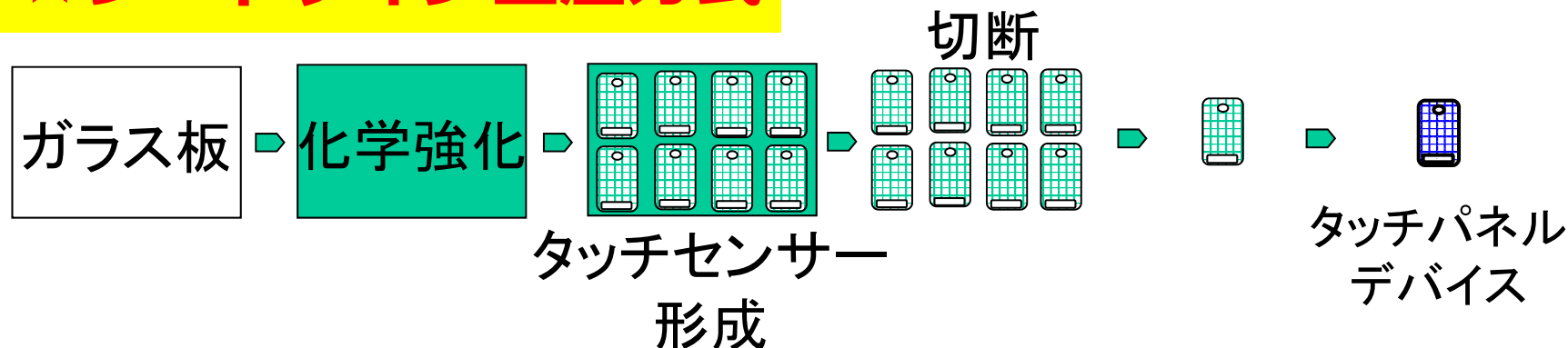
ガラススマートフォンやモバイルカーナビなどの技術機材は従来より、大手メーカーがスマートフォンに供給している。TOWAは透明率を高めるプロセスの全面強化を進めており、15年にも参入する計画だ。

- ・カバーガラスは薄くしたい
（携帯端末の軽量化・電池容積の確保・見栄え等）
- ・薄くても強度は必要 >>>>化学強化が必要

☆セルタイプ生産方式



☆シートタイプ生産方式



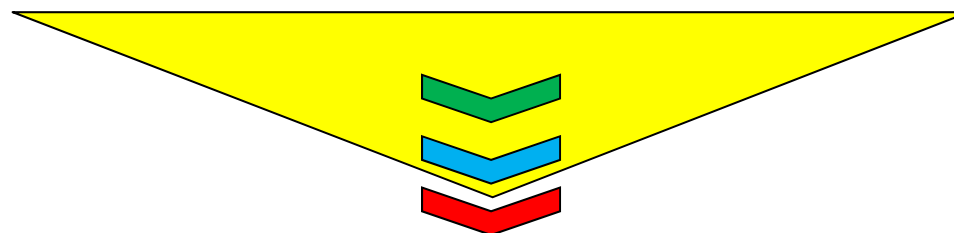
TOWAの狙い

1. 強化薄板硝子の切断プロセスの提案

(対象)

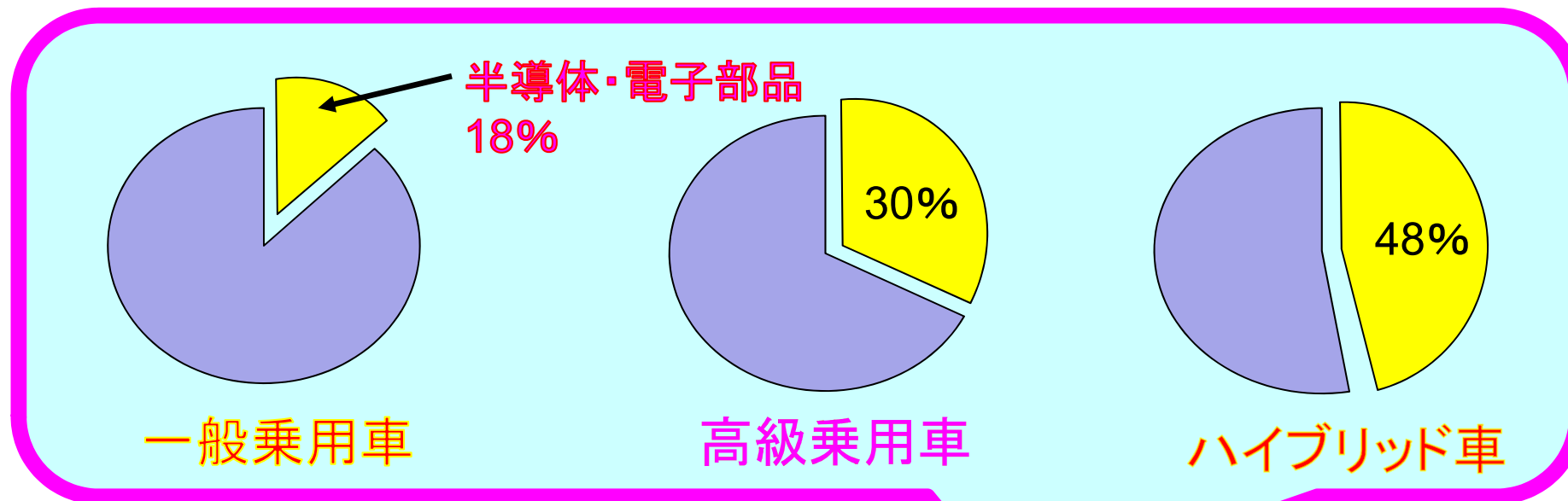
- ☆タッチパネル用カバーガラス加工企業
- ☆モジュールメーカー、ガラスメーカー

2. 受託加工も視野



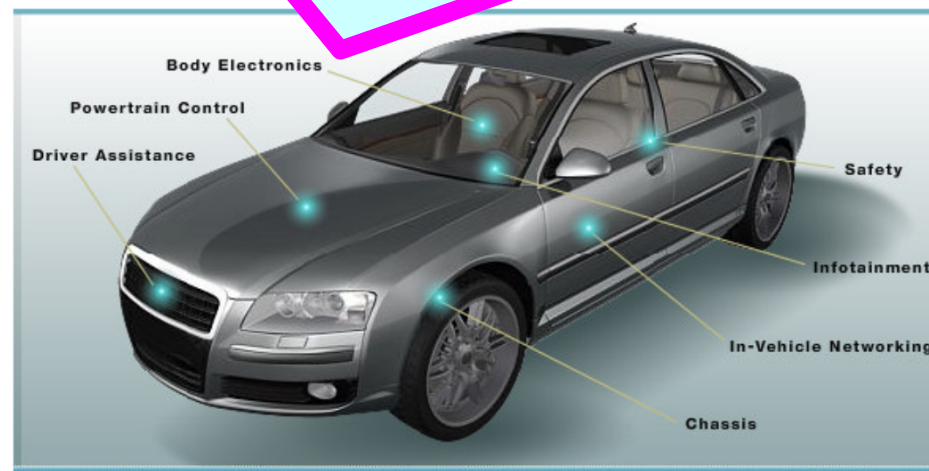
様々な可能性を追求して展開

自動車に占める半導体・電子部品の価格比率



自動・安全運転システムが
標準化へ……

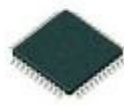
自動車はさらに
“電気製品化”が進む



TOWA実績サンプル

ECU (Electric Control Unit)

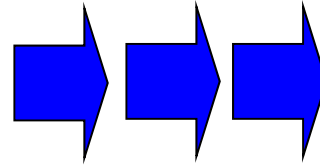
W:58mm x D:74mm x T:8mm



W:53mm x D:66mm x T:8mm

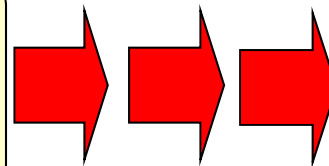
QFP W:10mm x D:10mm x T:1.4mm

コンプレッションの
応用展開

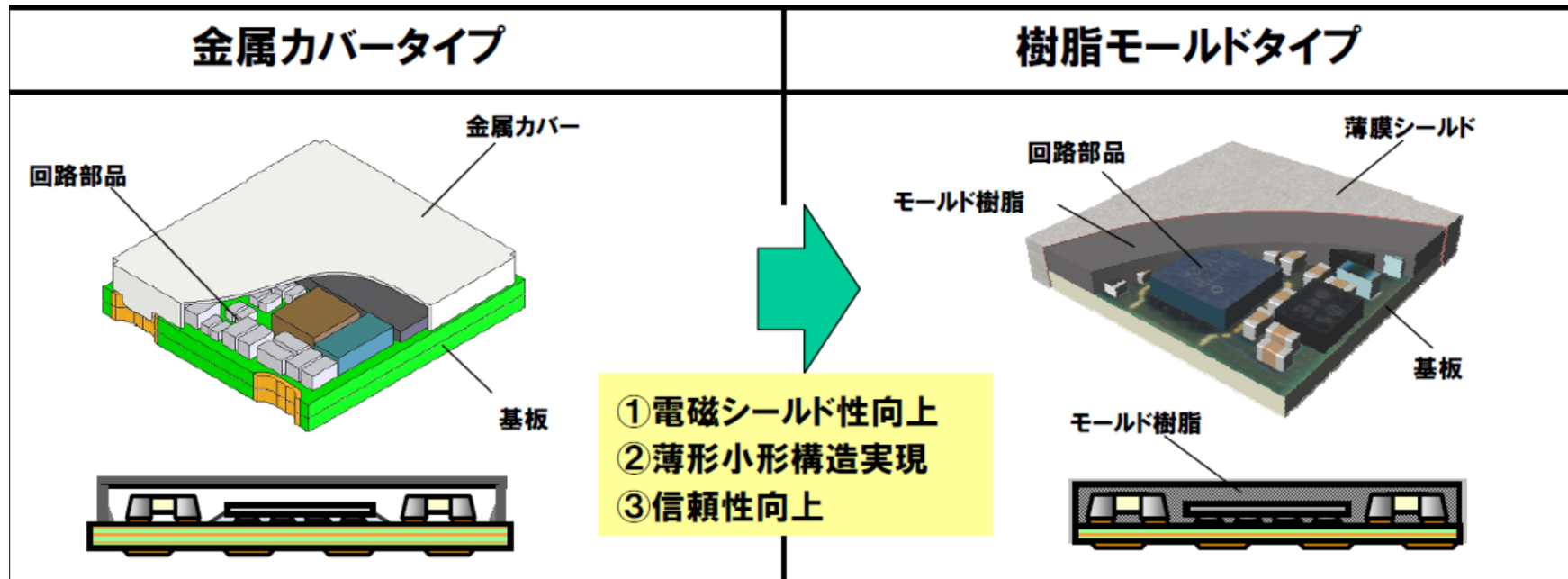


車載品
AVチューナ
電子部品

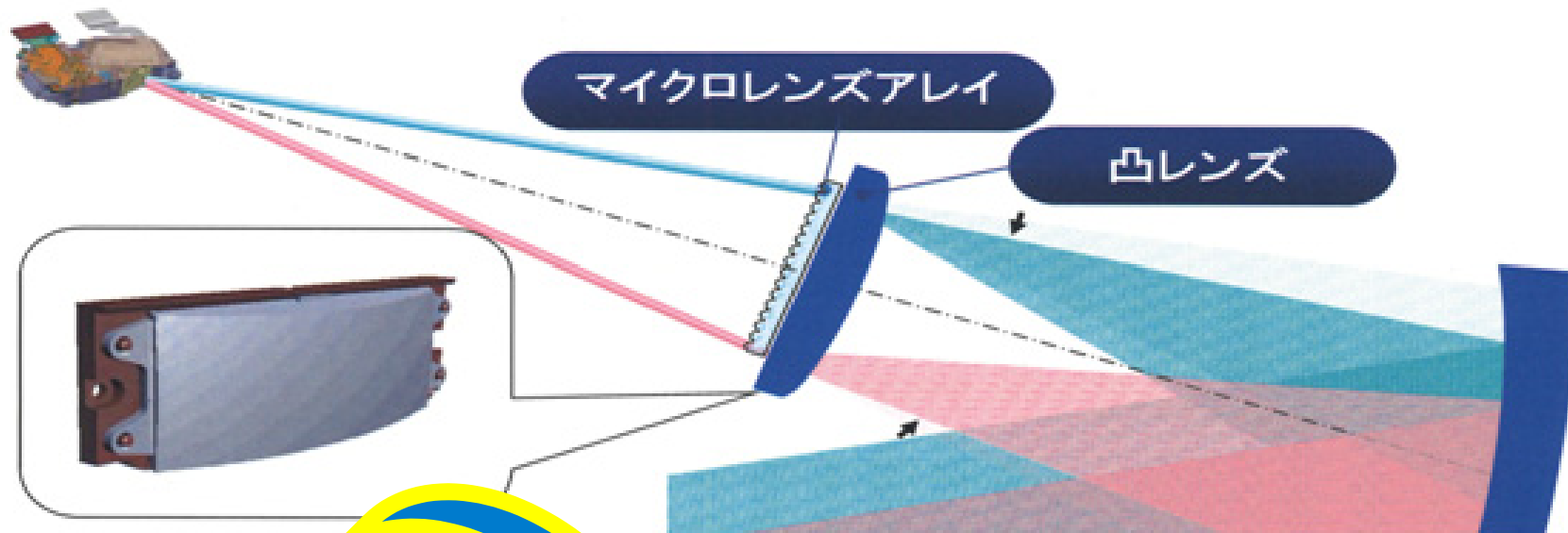
ケーシング
(金属カバー)



樹脂モールドへ
切り替わる



超微細金属加工技術を応用して…



Φ220mmの面積に、高さ $3.8\mu\text{m}$ のピラミッドを $0.3\mu\text{m}$ の精度で約50,000個配列できる金型加工技術

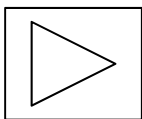
約3km四方の空港滑走路全域を蟻1匹(3mm)以下の高さで飛行機の高度制御することに匹敵する技術

高さ加工精度
 $3.8\mu\text{m} \pm 0.3\mu\text{m}$

10 μm
↔

新素材金型：バンセラ

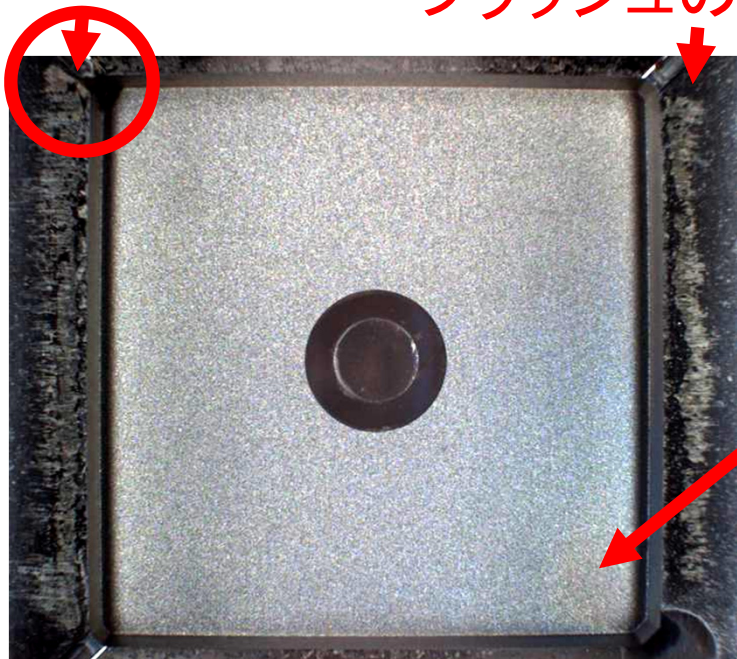
⇒ ⇒ 離型抵抗を極限まで減らした新素材



従来金型：300ショット目

樹脂の固着

フラッシュの堆積



キャビティ変色

バンセラ
1,000ショット目



上期から搬入開始→納品実績5社

- ☆ 抜群の離型性に高評価
- ☆ TOWAメンテによる生産性向上
- ☆ モールド設備の費用化に関心



「バンセラ」
+
「TSS」

※TSS : トータルソリューションサービス

さらに

- ◎ 樹脂の粘着性を高くできる⇒PKGの信頼性向上
- ◎ クリーニング成分不要⇒樹脂コストの低減
- ◎ 離型構造(インジェクターピン等)不要⇒金型コスト低減

バンセラの優位性をビジネス化へ...

☆ 工具販売（消耗品ビジネス）

エンドミル市場規模 130億円

⇒ 低価格のCBNエンドミル提供により
市場占有を進める

CBNボールエンドミル

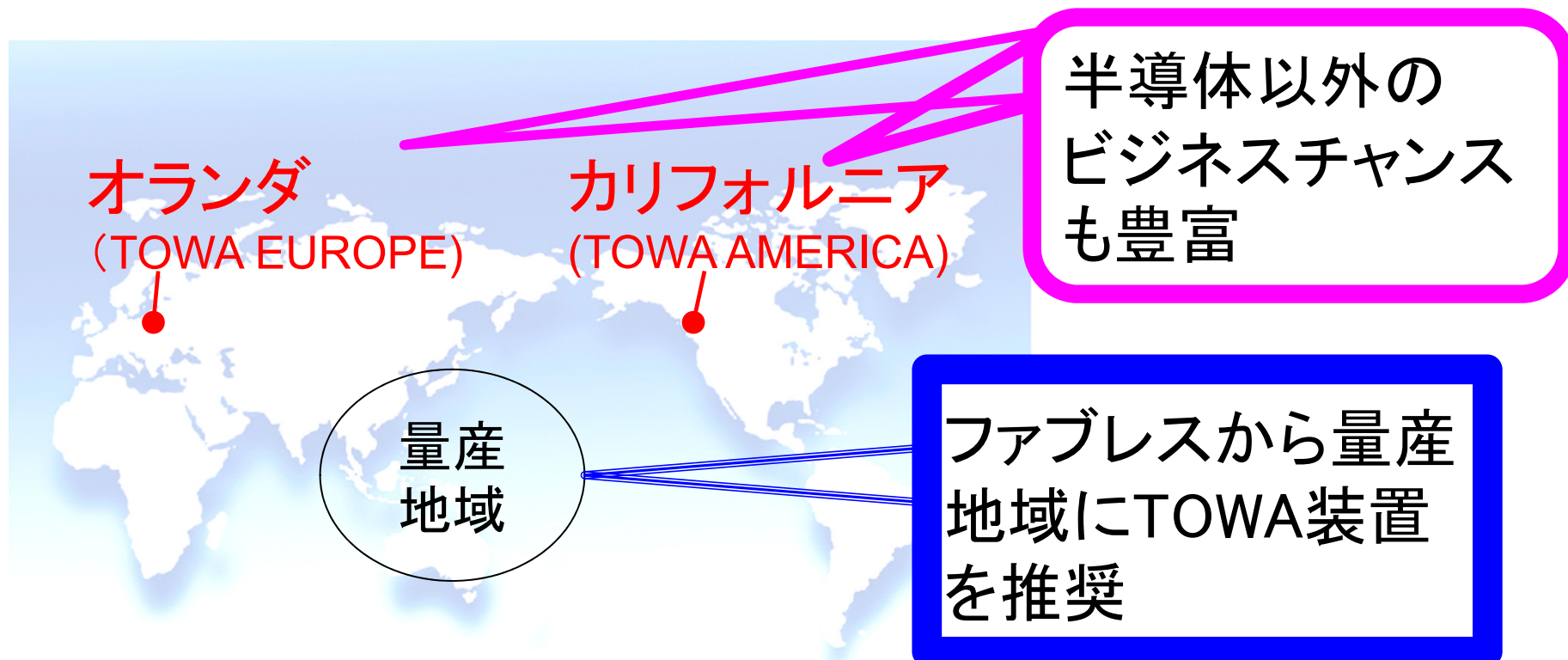
TOWA High Precision & Longer Life CBN Ball End Mill



北米・オランダの評価用ラボ

⇒半導体R&D、その他様々な案件・情報入手

▶▶▶ さらに評価装置を拡充してパワーアップ！！



「TOWA10年ビジョン」

テーマ

ものづくり企業の「真価に挑む」

(単位:億円)

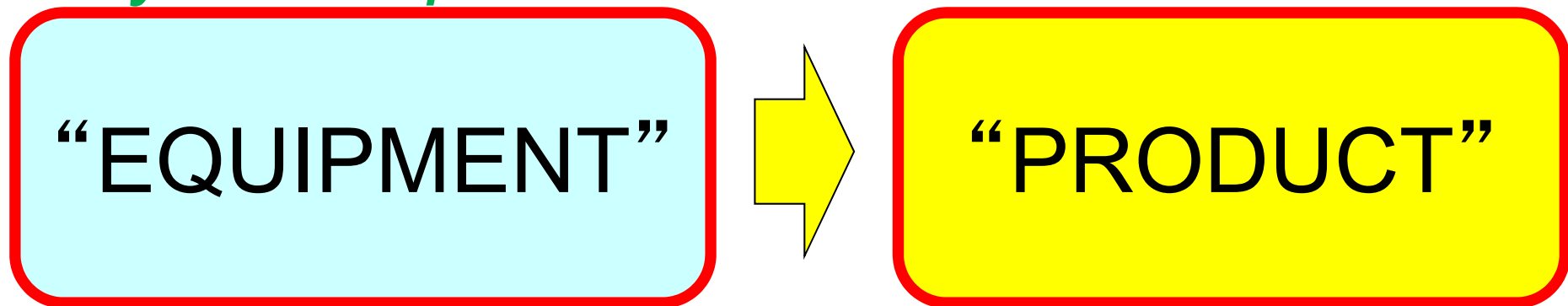
	現在	3年後	6年後	10年後
売上高	170	210	300	500
既存半導体製造装置以外比率	16%	21%	33%	50%
営業利益率	5%	10%	12%	16%

※既存半導体製造装置以外
=LED事業+化成品事業+「新たな市場」事業

～TOWA変革のプロローグ～

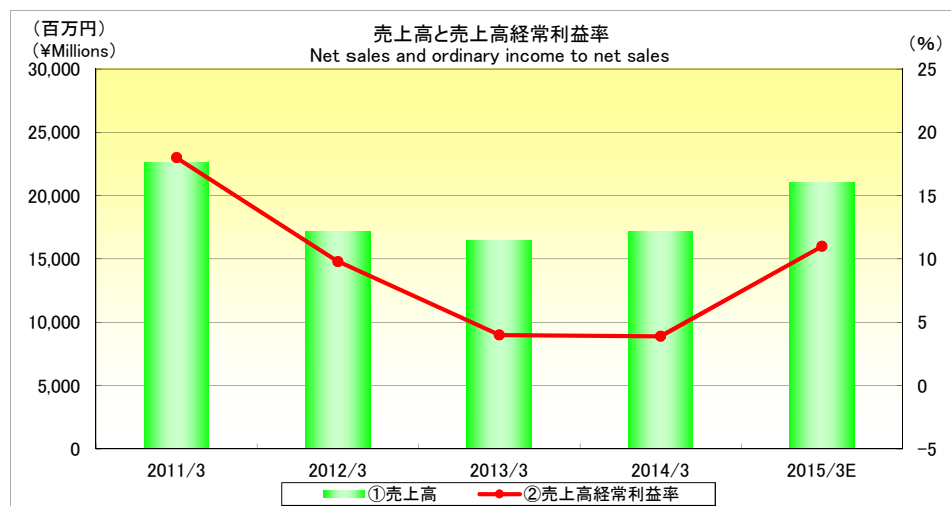
第1章

Key Concept

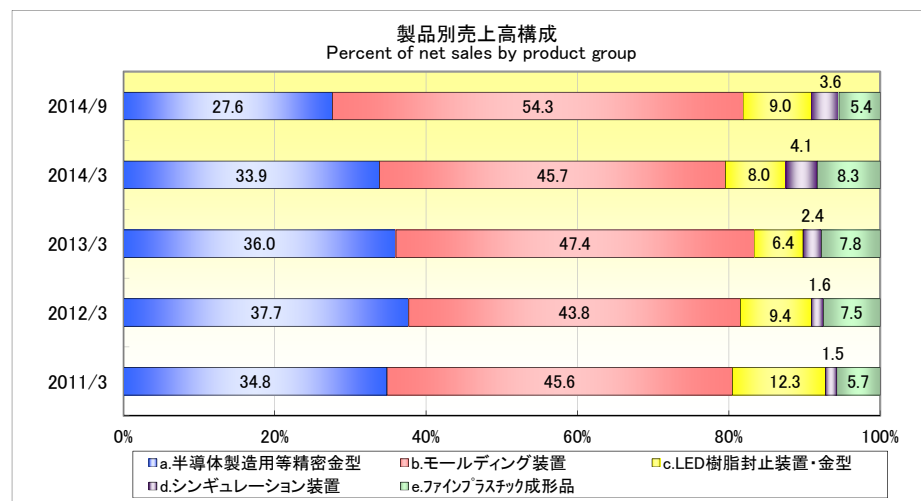


- TOWA事業の構造転換
- 新たな“価値”を創りだし、自ら供給する

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



①Net sales ②Ordinary income to net sales



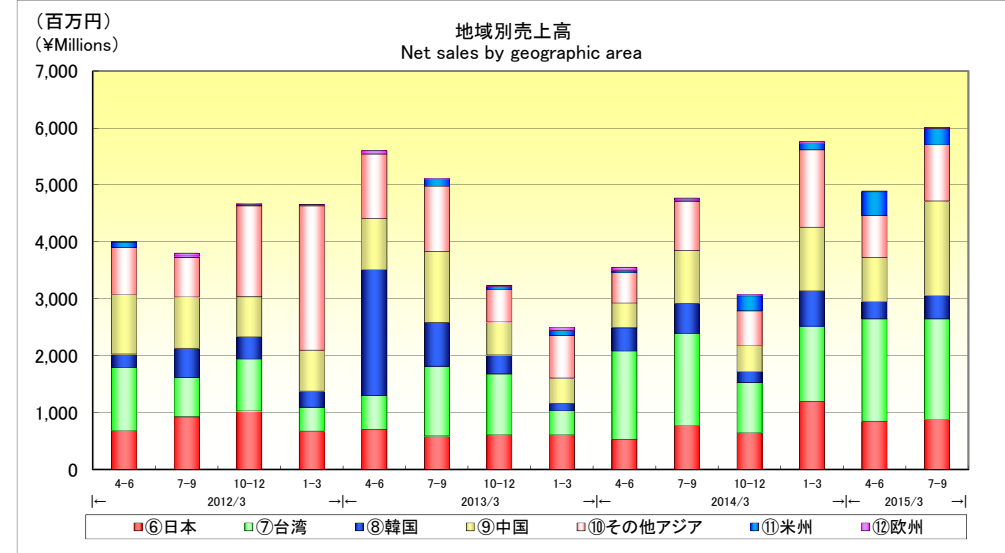
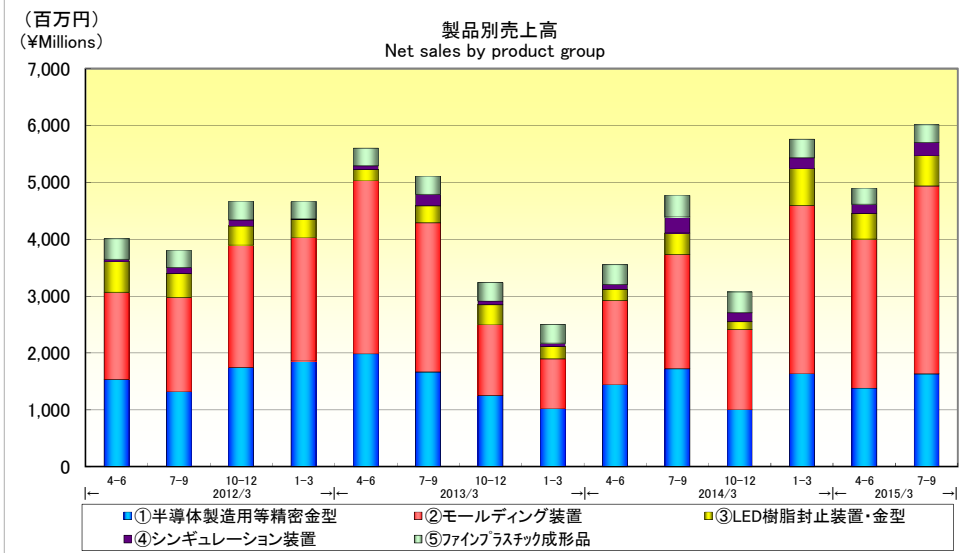
a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	Fiscal year	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3E
経営成績・財政状態 (百万円)	Operating results and financial conditions (¥Millions)					
売上高	Net sales	22,592	17,140	16,454	17,165	21,000
経常利益	Ordinary income	4,064	1,672	663	666	2,300
当期純利益	Net income	3,751	968	691	568	1,800
総資産	Total assets	27,288	26,817	25,896	29,132	-
純資産	Net assets	14,771	15,926	17,072	17,909	-
1株当たり指標(円)	Per share data(¥)					
1株当たり当期純利益	Net income per share	150.00	38.71	27.64	22.72	71.97
諸指標(%)	Data(%)					
自己資本当期純利益率	Return on equity	29.0	6.3	4.2	3.3	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	15.0	6.2	2.5	2.4	-
売上高経常利益率	Ordinary income to net sales	18.0	9.8	4.0	3.9	11.0
自己資本比率	Equity ratio	54.1	59.4	65.2	60.6	-

(単位:百万円/¥Millions)

	2013/9	2014/9
売上高	8,328	10,913
経常利益	100	1,468
当期純利益	52	1,088
総資産	27,210	31,650
純資産	17,207	19,528
1株当たり当期純利益	2.10	43.53
自己資本当期純利益率	-	-
総資産経常利益率	-	-
売上高経常利益率	1.2	13.5
自己資本比率	62.4	60.7

II. 四半期売上高動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



製品別売上高 Net sales by product group

(単位: 百万円/¥Millions)

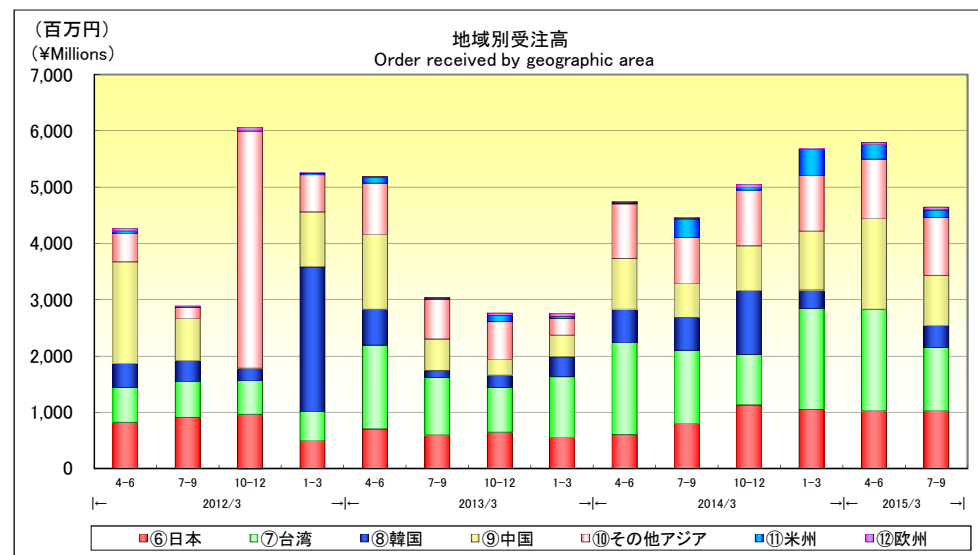
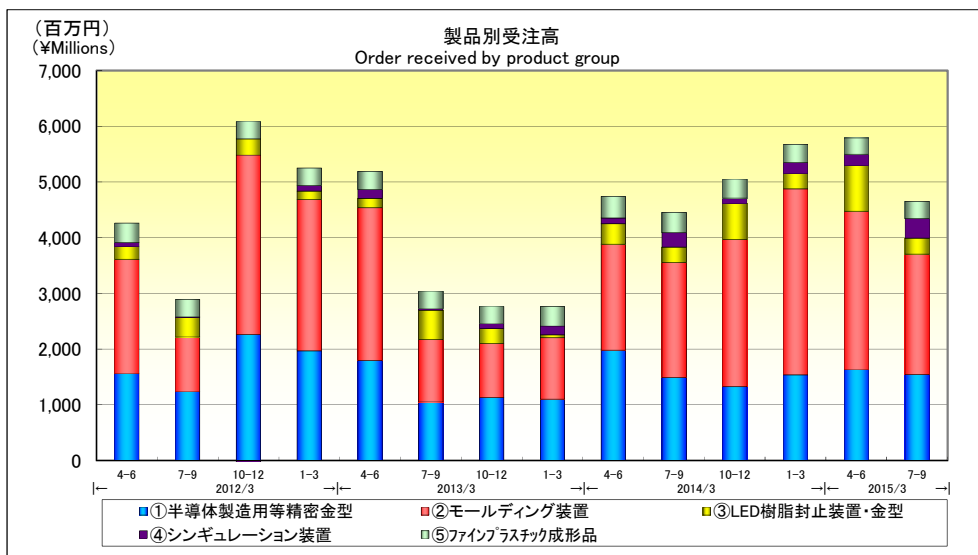
決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	6,016	10,913
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	1,026	5,923	1,443	1,723	1,009	1,634	5,810	1,382	1,632	3,015
モールドング装置 ② Semiconductor plastic encapsulation systems	1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	870	7,801	1,479	2,007	1,406	2,958	7,852	2,620	3,305	5,926
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	544	418	333	312	1,608	187	299	347	220	1,055	197	378	133	657	1,367	451	532	983
シンギュレーション装置 ④ Singulation parts and systems	38	104	111	12	267	67	204	65	57	395	82	285	158	182	710	163	233	396
ファインプラスチック成形品 ⑤ Engineering plastic molded products	359	303	323	301	1,287	311	318	322	325	1,277	351	377	367	327	1,424	279	311	591
月平均	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	834	1,371	1,185	1,591	1,025	1,430	1,632	2,005	1,819	

地域別売上高 Net sales by geographic area

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	6,016	10,913
日本 ⑥ Japan	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	614	2,521	527	772	654	1,195	3,150	849	884	1,734
台湾 ⑦ Taiwan	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	423	3,314	1,556	1,619	873	1,326	5,376	1,800	1,763	3,564
韓国 ⑧ Korea	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	119	3,428	408	528	189	618	1,745	305	409	714
中国 ⑨ China	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	453	3,189	436	926	462	1,116	2,941	767	1,662	2,429
その他アジア ⑩ Other asia	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	748	3,604	543	870	609	1,361	3,384	743	987	1,731
米州 ⑪ America	94	32	25	11	164	14	112	53	89	269	31	20	263	112	428	418	284	703
欧州 ⑫ Europe	10	47	4	11	74	44	16	12	52	126	51	34	23	137	12	23	35	

Ⅲ. 四半期受注高動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



製品別受注高 Order received by product group

(単位:百万円/¥Millions)

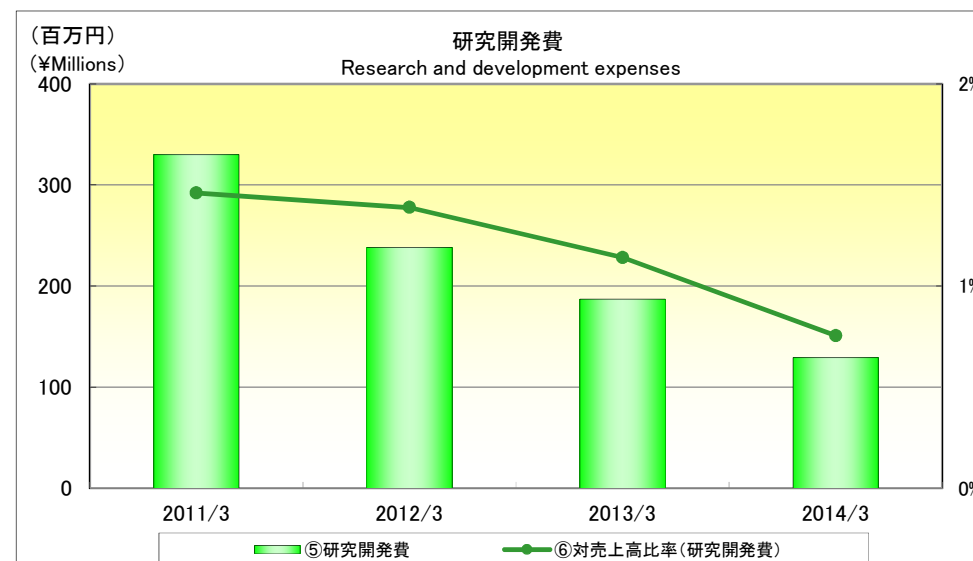
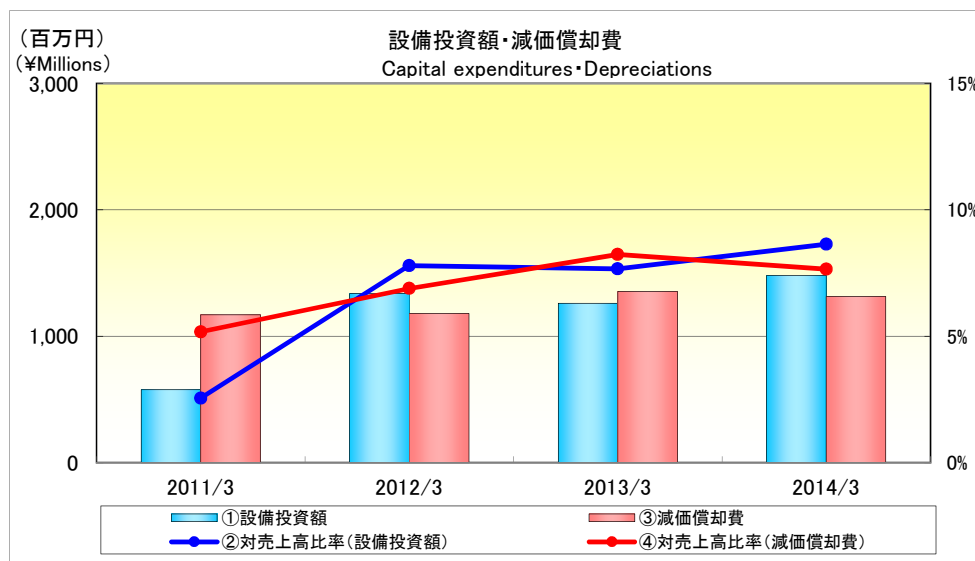
決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,793	4,648	10,441
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	1,101	5,083	1,980	1,490	1,326	1,539	6,336	1,633	1,545	3,178
モールドディング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	1,103	5,934	1,904	2,067	2,643	3,339	9,954	2,841	2,158	5,000
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	227	348	289	147	1,013	168	529	270	53	1,021	365	275	642	273	1,556	820	289	1,109
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	73	16	-29	103	164	160	30	90	158	439	107	257	101	198	664	203	351	555
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	350	307	309	313	1,281	322	306	304	346	1,279	383	362	335	327	1,409	294	303	598
月平均	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	921	1,147	1,580	1,485	1,683	1,892	1,660	1,931	1,549	1,740

地域別受注高 Order received by geographic area

(単位:百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,793	4,648	10,441
日本 ⑥Japan	821	906	963	495	3,187	703	593	645	551	2,494	602	802	1,130	1,048	3,583	1,023	1,036	2,060
台湾 ⑦Taiwan	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	1,079	4,392	1,639	1,299	894	1,793	5,626	1,805	1,110	2,915
韓国 ⑧Korea	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	352	1,328	592	583	1,139	330	2,645	1	392	394
中国 ⑨China	1,801	746	-8	981	3,520	1,327	564	284	389	2,566	902	598	794	1,046	3,341	1,608	895	2,503
その他アジア ⑩Other asia	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	293	2,579	966	823	990	989	3,770	1,060	1,030	2,091
米州 ⑪America	44	19	27	25	117	99	16	112	34	263	17	330	49	467	864	266	132	399
欧州 ⑫Europe	43	4	46	9	104	16	13	42	62	134	20	16	50	2	89	27	49	76

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)	(Consolidated)	(単位: 百万円/¥Millions)					
決算期	Fiscal year	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2014/9	
キャッシュフロー	Cash flows						
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	5,571	1,897	2,710	935	1,457	
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-620	-112	-1,083	-1,553	-1,081	
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-3,808	-2,280	-817	819	65	
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	4,933	4,395	5,266	5,533	6,058	
設備投資額	①Capital expenditures	578	1,336	1,262	1,482	478	
対売上高比率(%)	②Ratio of sales (%)	2.56	7.79	7.67	8.64	4.38	
減価償却費	③Depreciations	1,170	1,181	1,354	1,314	582	
対売上高比率(%)	④Ratio of sales (%)	5.18	6.89	8.23	7.66	5.34	
研究開発費	⑤Research and development expenses	330	238	187	129	97	
対売上高比率(%)	⑥Ratio of sales (%)	1.46	1.39	1.14	0.75	0.90	
							2013/9
							8
							-857
							209
							4,623
							524
							6.29
							621
							7.46
							63
							0.76

この資料に関するお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。